PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-156750

(43)Date of publication of application: 31.05.2002

(51)Int.CI.

G03F 7/004 CO8F 20/18 CO8F 32/00 CO8K 5/45 C08L101/02 H01L 21/027

(21)Application number: 2000-352700

(71)Applicant: SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

20.11.2000

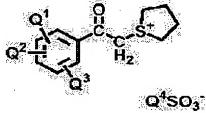
(72)Inventor: KAMIYA YASUNORI

OHASHI KENJI: MORIUMA HIROSHI

(54) CHEMICAL AMPLIFICATION TYPE POSITIVE RESIST COMPOSITION (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resist composition, having proper various resist performances, such as sensitivity, resolution and adhesiveness with respect to substrate and superior profile shape as a chemical amplification type positive resist composition, containing a resin and an acid generating agent and suitable for lithography with an excimer laser, such as ArF or KrF.

SOLUTION: The chemical amplification type positive resist composition contains an alkali-insoluble or slightly alkali-soluble resin, having an alkali- soluble group protected by a 2-alkyl-2-adamantyl group or a 1adamantyl-1- alkylalkyl group and convertible to an alkali-soluble resin by the action of an acid and a sulfonium salt type acid generating agent of formula (1) (wherein Q1-Q3 are each H, hydroxyl, a 1-6C alkyl or a 1-6C alkoxy and Q4 is perfluoroalkyl which may have a cyclic structure).



ŰÎ.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(11)特許出願公開番号 特開2002-156750 (P2002-156750A)

(43)公開日 平成14年5月31日(2002.5.31)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコート*(参考)
G03F 7/004	503	G03F 7/004	503A 2H025
C08F 20/18		C08F 20/18	4 J 0 0 2
32/00		32/00	4 J 1 0 0
C08K 5/45		C08K 5/45	17100
C 0 8 L 101/02		C 0 8 L 101/02	
	審査請求		(全 10 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顏2000-352700(P2000-352700)	(71) 出願人 000002093	
		住友化学工業	株式会社
(22)出願日	平成12年11月20日(2000.11.20)	大阪府大阪市	中央区北浜 4 丁目 5 番33号
		(72)発明者 上谷 保則	
		大阪市此花区	F日出中3丁目1番98号 住
		友化学工業株	式会社内
		(72)発明者 大橋 實治	
			静日出中3丁目1番98号 住
		友化学工業株	
		(74)代理人 100093285	
		弁理士 久保	山隆(外2名)
	·		- III () - II
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 化学増幅型ポジ型レジスト組成物

(57)【要約】

【課題】樹脂成分と酸発生剤を含有し、ArFやKrF などのエキシマレーザーリソグラフィに適した化学増幅型のポジ型レジスト組成物であって、感度や解像度、基板への接着性などの各種レジスト性能が良好であるとともに、プロファイルの形状に優れるレジスト組成物を提供する。

【解決手段】2-アルキル-2-アダマンチル基、または1-アダマンチル-1-アルキルアルキル基で保護されたアルカリ可溶性基を有し、それ自身はアルカリに不溶又は難溶であるが、酸の作用でアルカリに可溶となる樹脂、および下式(I)

$$Q^{2} \xrightarrow{C} C \xrightarrow{S^{+}} C \xrightarrow{C} C \xrightarrow{S^{+}} Q^{4}SO_{3}^{-}$$

$$Q^{4}SO_{3}^{-}$$

$$Q^{4}SO_{3}^{-}$$

(式中、Q¹、Q²及びQ³は、互いに独立に、水素、水酸基、炭素数1~6のアルキル又は炭素数1~6のアルコキシを表し、Q¹は、環状構造を有しても良いパーフルオロアルキルを示す。)で示されるスルホニウム塩系酸発生剤を含有する化学増幅型ポジ型レジスト組成物。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】2-アルキル-2-アダマンチル基、又は 1-アダマンチル-1-アルキルアルキル基で保護され たアルカリ可溶性基を有し、それ自身はアルカリに不溶 又は難溶であるが、酸の作用でアルカリに可溶となる樹 脂、及び下式(!)

(式中、R₁、R₂は、水素又はメチルを表し、R₂~R₃は、アルキルを表す)で示される重合単位のいずれかを含有する共重合体を用いる請求項1記載の組成物。

【請求項3】式(Ⅰ)中のQ゚が炭素数が4以上である する樹脂環状構造を有しても良いパーフルオロアルキルである請 30 られる。 求項1記載の組成物。 【000

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体の微細加工 に用いられる化学増幅型のポジ型レジスト組成物に関す るものである。

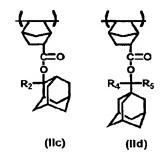
[0002]

【従来の技術】半導体の微細加工には、通常、レジスト組成物を用いたリソグラフィプロセスが採用されており、リソグラフィにおいては、レイリー(Rayleigh)の 40回折限界の式で表されるように、原理的には露光波長が短いほど解像度を上げることが可能である。半導体の製造に用いられるリソグラフィ用露光光源は、波長436mmの g線、波長365mmの i線、波長248mmの K r F エキシマレーザーと、年々短波長になってきており、次世代の露光光源として、波長193mmのA r F エキシマレーザーが有望視されている。

【0003】ArFエキシマレーザー露光機に用いられるレンズは、従来の露光光源用のものに比べて寿命が短いので、ArFエキシマレーザー光に曝される時間はで 50

* (式中、Q¹、Q²及びQ³は、互いに独立に、水素、水酸基、炭素数1~6のアルキル又は炭素数1~6のアルコキシを表し、Q¹は、環状構造を有しても良いバーフルオロアルキルを示す。)で示されるスルホニウム塩系酸発生剤を含有することを特徴とする化学増幅型ポジ型レジスト組成物。

【請求項2】2-アルキル-2-アダマンチル基、又は 1-アダマンチル-1-アルキルアルキル基で保護され たアルカリ可溶性基を有し、それ自身はアルカリに不溶 10 又は難溶であるが、酸の作用でアルカリに可溶となる樹 脂として、下式(IIa)、(IIb)、(IIc)、 (IId)、



きるだけ短いことが望ましい。そのためには、レジストの感度を高める必要があることから、露光により発生する酸の触媒作用を利用し、その酸により解裂する基を有する樹脂を含有するいわゆる化学増幅型レジストが用いられる。

【0004】ArFエキシマレーザー露光用のレジスト に用いる樹脂は、レジストの透過率を確保するために芳香環を持たず、またドライエッチング耐性を持たせるために芳香環の代わりに脂環式環を有するものがよいことが知られている。このような樹脂としてこれまでに、D.C. Hofer, J. Photopolym. Sci. Technol., Vol.9,No.3, 387–398 (1996) に記載されるような各種の樹脂が知られている。

【0005】特にS. Takechi et al, J. Photopolym. S ci. Technol., Vol.9, No.3, 475-487 (1996) や特開平 9-73173 号公報に示されるような2-アルキル-2-アダマンチル基、又は1-アダマンチル-1-アルキルアルキル基で保護されたアルカリ可溶性基を有する重合体又は共重合体を化学増幅型レジストの樹脂として用いた場合には、高いドライエッチング耐性、高解像性及び基板への良好な接着性が得られることが報告されている

【0006】2-アルキル-2-アダマンチル基、又は 1-アダマンチル-1-アルキルアルキル基で保護され たアルカリ可溶性基を有する重合体又は共重合体は、コ

ントラストが高く高い解像度が得られる。しかし、プロ ファイルの頭が張ってT-top形状になりやすい欠点 がある。この原因としては、アダマンチル基の疎水性が 高く現像液とのなじみが悪いことや、レジスト表面で酸 が雰囲気中の塩基性物質で失活することが考えられてい る。この問題を解決するには、塩基性のクェンチャー物 質を多く添加すればよいことが知られている。しかしな がら、このようにクェンチャー物質を多く添加すると、 感度が低下する。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、樹脂 成分と酸発生剤を含有し、ArFやKrFなどのエキシ マレーザーリソグラフィに適した化学増幅型のポジ型レ ジスト組成物であって、感度や解像度、基板への接着性 などの各種レジスト性能が良好であるとともに、プロフ ァイルの形状に優れるレジスト組成物を提供することに ある。

[0008]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、2 -アルキル-2-アダマンチル基、又は1-アダマンチ 20 ルー1-アルキルアルキル基で保護されたアルカリ可溶 性基を有し、それ自身はアルカリに不溶又は難溶である が、酸の作用でアルカリに可溶となる樹脂、及び下式 (I)

[0009]

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} R_1 \\ CH_2 - C \\ C \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} R_3 \\ CH_2 - C \\ C \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} R_3 \\ CH_2 - C \\ C \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} R_3 \\ CH_2 - C \\ C \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} R_3 \\ CH_2 - C \\ C \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} R_3 \\ CH_2 - C \\ C \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_2 - C \\ C \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_2 - C \\ C \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} CH_2 - C \\ C \end{array} \begin{array}{c} CH_2 - C$$

(式中、R1、R1は、水素又はメチルを表し、R2~R5 は、アルキルを表す)で示される重合単位を有する樹脂 が挙げられる。

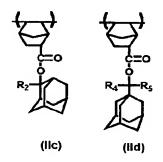
【0012】式(IIa)~(IId)で示される重合 単位は、脂環式環であるアダマンタン環の存在により、 レジストの透過率を確保し、またドライエッチング耐性 の向上に寄与する。さらに、この単位中の2-アルキル -2-アダマンチル基、1-アダマンチル-1-アルキ ルアルキル基は酸の作用により解裂し、カルボン酸を発 生するので、この単位は、レジスト膜の露光後のアルカ リ溶解性を高めるのに寄与する。式(IIa)~(II d)中のR₂は、アルキルであり、このアルキルは、例 えば炭素数1~8程度であることができ、通常は直鎖で

*
$$Q^1$$
 Q^1 Q^2 Q^3 Q^4 Q^3 Q^4 Q^3

【0010】(式中、Q'、Q'及びQ'は、互いに独立 10 に、水素、水酸基、炭素数1~6のアルキル又は炭素数 1~6のアルコキシを表し、Q'は、環状構造を有して も良いパーフルオロアルキルを示す。) で示されるスル ホニウム塩系酸発生剤を含有する化学増幅型ポジ型レジ スト組成物を提供するものである。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明のレジスト組成物を構成す る樹脂は、2-アルキル-2-アダマンチル基、又は1 -アダマンチル-1-アルキルアルキル基で保護された アルカリ可溶性基を有し、それ自身はアルカリに不溶又 は難溶であるが、酸の作用でアルカリに可溶となる樹脂 である。アルカリ可溶性基としては、カルボン酸基、フ ェノール基、ヘキサフルオロイソプロパノール基などが 挙げられるが、ArFレジストの場合は通常カルボン酸 基が用いられる。具体的には、下式(IIa)、(II b), (IIc), (IId),



いても構わない。具体的なR'としては、メチル、エチ ル、プロピル、イソプロビル、ブチルなどが挙げられ る。なかでも、Rぇがメチル又はエチル、とりわけエチ ルであるものは、レジストと基板との接着性や解像度の 向上にとって好都合である。式(IIa)~(IId) で示される重合単位に導くためのモノマーとして、具体 的には例えば、アクリル酸2-メチル-2-アダマンチ ル、アクリル酸2-エチル-2-アダマンチル、メタク リル酸2-メチル-2-アダマンチル、メタクリル酸2 -エチル-2-アダマンチル、アクリル酸1-アダマン チルー1ーメチルエチル、メタクリル酸1ーアダマンチ・ ルー1-メチルエチル、5-ノルボルネン-2-カルボ ン酸2-メチル-2-アダマンチル、5-ノルボルネン あるのが有利であるが、炭素数3以上の場合は分岐して 50 -2-カルボン酸2-エチル-2-アダマンチル5-ノ

ルボルネン-2-カルボン酸1-(1-アダマンチル) - 1 - メチルエチル、などが挙げられる。とりわけ(メ タ) アクリル酸2-アダマンチル-2-アルキルをモノ マーとして用いた場合は、解像度が優れるので好まし

5

【0013】樹脂としては上記のような重合単位の他 に、例えば下記に示すようなモノマーの重合単位を有す ることができる。

【0014】(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル、(メタ)アクリル酸3、5-ジヒドロキ 10 シー1-アダマンチル、α-(メタ)アクリロイロキシ -γ-ブチロラクトン、β-(メタ)アクリロイロキシ - γ - ブチロラクトン、無水マレイン酸、無水イタコン 酸、5-(メタ) アクリロイロキシ-2、6-ノルボルナ ンカルボラクトン、2-ノルボルネン2-ヒドロキシー 5-ノルボルネン、5-ノルボルネン-2-カルボン 酸、5-ノルボルネン-2-カルボン酸メチル5-ノル ボルネン-2-カルボン酸-t-ブチル5-ノルボルネ ン-2-カルボン酸1-シクロヘキシル-1-メチルエ チル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-(4-メ チルシクロヘキシル) -1-メチルエチル、5-ノルボ ルネン-2-カルボン酸1-(4-ヒドロキシシクロへ キシル) -1-メチルエチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-メチル-1-(4-オキソシクロヘキシ ル) エチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-(1-アダマンチル)-1-メチルエチル、5-ノルボ ルネン-2-カルボン酸1-メチルシクロヘキシル、5 - ノルボルネン-2-カルボン酸2-メチル-2-アダ マンチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸2-エチ ルー2-アダマンチル5-ノルボルネン-2-カルボン 30 るスルホニウム塩系の化合物を酸発生剤として用いる。 酸2-ヒドロキシ-1-エチル、5-ノルボルネン-2 - メタノール、5 - ノルボルネン - 2,3 - ジカルボン 酸無水物、(メタ)アクリロニトリルなど。

【0015】化学増幅型ポジ型レジスト用の樹脂は、一 般に、それ自体はアルカリに不溶又は難溶であるが、酸 の作用により一部の基が解裂し、解裂後はアルカリ可溶 性となるものであり、本発明において特定する樹脂で は、2-アルキル-2-アダマンチル基、1-アダマン チル-1-アルキルアルキル基が酸の作用により解裂す 型に作用するが、必要に応じて、酸の作用により解裂す る他の基を有する重合単位を含んでもよい。酸の作用に より解裂する他の基として具体的には、カルボン酸の各 種エステル、例えば、メチルエステルやtert-ブチルエ ステルに代表されるアルキルエステル、メトキシメチル エステル、エトキシメチルエステル、1-エトキシエチ ルエステル、1-イソプトキシエチルエステル、1-イ ソプロポキシエチルエステル、1-エトキシプロピルエ ステル、1-(2-メトキシエトキシ) エチルエステ

ル、1-(2-アセトキシエトキシ)エチルエステル、 1-[2-(1-アダマンチルオキシ)エトキシ]エチ ルエステル、1-(2-(1-アダマンタンカルボニル オキシ) エトキシ] エチルエステル、テトラヒドロー2 -フリルエステル及びテトラヒドロ-2-ビラニルエス テルのようなアセタール型エステル、イソボルニルエス テルのような脂環式エステルなどが挙げられる。このよ うなカルボン酸エステルを有する重合単位へ導くモノマ ーは、メタクリル酸エステルやアクリル酸エステルのよ うなアクリル系のものでもよいし、ノルボルネンカルボ ン酸エステル、トリシクロデセンカルボン酸エステル、 テトラシクロデセンカルボン酸エステルのように、カル ボン酸エステル基が脂環式モノマーに結合したものでも

【0016】本発明で用いる樹脂は、バターニング露光 用の放射線の種類や酸の作用により解裂する基の種類な どによっても変動するが、一般には、酸の作用により解 裂する基を有する重合単位を30~80モル%の範囲で 含有するのが好ましい。そして、酸の作用により解裂す 20 る基として特に、式(IIa)~(IIb)で示される 重合単位は、樹脂全体のうち20モル%以上とするのが 有利である。

【0017】レジスト組成物のもう一つの成分である酸 発生剤は、その物質自体に、あるいはその物質を含むレ ジスト組成物に、光や電子線などの放射線を作用させる ことにより、その物質が分解して酸を発生するものであ る。酸発生剤から発生する酸が前記樹脂に作用して、そ の樹脂中に存在する酸の作用で解裂する基を解裂させる ことになる。本発明においては、前記式(I)で示され 【0018】式(I) において、Q¹、Q²及びQ³は、 互いに独立に、水素、水酸基、炭素数1~6のアルキル 又は炭素数1~6のアルコキシであり、アルキル及びア ルコキシは、炭素数3以上の場合は直鎖でも分岐してい てもよい。具体的なアルキルの例としては、メチル、エ チル、プロピル、イソプロピル、ブチル、tert-ブチ ル、ペンチル、ヘキシルなどが挙げられ、アルコキシの 例としては、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキ シなどが挙げられる。このような化合物を酸発生剤とし る。したがって、この樹脂を含むレジスト組成物はポジ 40 て用いることにより、レジストのプロファイルのT-t o p 形状が緩和される。

> 【0019】式(1)で示されるスルホニウム塩は、公 知の方法に準じて製造することが可能である。例えば、 J. V. Crivello et al., J. Polymer Science., Polyme r Chemistry Edition, Vol.17, 2877-2892 (1979) に 記載の方法を応用して、次の反応スキームに従って製造 することができる。

[0020]

(A1) (A2)

【0021】式中、Q1、Q1、Q1は、先に定義したと おりであり、Yは臭素や沃素のようなハロゲンを表し、 Mは、ナトリウム、カリウムのようなアルカリ金属及び 銀を表す。

【0022】すなわち、上記式 (A1) に相当するスルフ ィド化合物に(A2)に相当するβ-ハロゲノケトンを作用 させて、上記式(B)に相当するスルホニウムハライド を生成させ、さらに式Q'SO,M に相当するスルホン 酸金属塩を作用させることにより、式(1)で示される。 スルホニウム塩を得ることができる。これらの反応は、 適当な溶媒中、例えば、アセトン、アセトニトリル、ニ トロメタンなどの溶媒中で行われる。式 (A1) のスルフ ィド化合物は、式(A2)に相当するβ-ハロゲノケトンに 対して、好ましくは0.7~1.5モル比用い、さらに 20 好ましくは、0.8~1.1モル比用いる。また、式Q 'SO,M に相当するスルホン酸金属塩は、式(B)の スルホニウムハライド生成のために用いた式 (A1) のス ルフィド化合物に対して、0.7~1.2モル比、好ま しくは0.8~1.0モル比用いればよい。反応終了後 は、生成したハロゲン化金属塩を濾過等により除去し、 次いで濃縮や再結晶等の後処理を施すことにより、式 (1) のスルホニウム塩を得ることができる。

【0023】式(1)において、陰イオンである環状構 造を有しても良いパーフルオロアルキルスルホネート陰 30 イオンとしては、トリフルオロメタンスルホネートイオ ン、パーフルオロブタンスルホネートイオン、パーフル オロオクタンスルホネートイオン、パーフルオロシクロ ヘキサンスルホネートイオン、パーフルオロ4ーエチル -シクロヘキサンスルホネートイオンなどが挙げられ る。パーフルオロアルキルスルホン酸イオンの炭素数 は、4以上のほうが酸拡散距離が小さく、解像度に優れ るため好ましい。

【0024】本発明のレジスト組成物は、2-アルキル -2-アダマンチル基、又は1-アダマンチル-1-ア 40 ルキルアルキル基で保護されたアルカリ可溶性基を有 し、それ自身はアルカリに不溶又は難溶であるが、酸の 作用でアルカリに可溶となる樹脂に、前記式(1)で示 されるスルホニウム塩を酸発生剤として組み合わせたも のであるが、所望によりこのスルホニウム塩に加えて、 他の酸発生剤を併用することも可能である。併用しうる 他の酸発生剤には、式([)で示されるスルホニウム塩 以外のスルホニウム塩やヨードニウム塩のような他のオ ニウム塩化合物、例えばジフェニルヨードニウム塩やト

(B)

報で示されるようなシクロヘキシルメチル(2-オキソ シクロヘキシル)スルホニウム塩、 S. Iwasa et al, J. Photopolym. Sci. Technol., Vol.13, No.2, 235-23 6 (2000) に記載されている2-オキソブチルチアシク ロペンタニウム塩等のアルキルスルホニウム塩;ハロア ルキルトリアジン化合物のような有機ハロゲン化合物; ジスルホン類やジアゾメタンジスルホン類のようなスル ホン化合物、各種スルホン酸エステルなどが包含され る。

【0025】併用しうる他の酸発生剤として、次のよう なものが挙げられる。 ジフェニルヨードニウム トリフ ルオロメタンスルホネート、4-メトキシフェニルフェ ニルヨードニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4 ーメトキシフェニルフェニルヨードニウム トリフルオ ロメタンスルホネート、ピス(4-tert-ブチルフェニ ル) ヨードニウム テトラフルオロボレート、ビス(4 -tert-ブチルフェニル) ヨードニウム ヘキサフルオ ロホスフェート、ビス (4-tert-ブチルフェニル) ヨ ードニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ビス (4) -tert-ブチルフェニル) ヨードニウム トリフルオロ メタンスルホネート、

【0026】トリフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロホスフェート、トリフェニルスルホニウム ヘキサフ ルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウム ト リフルオロメタンスルホネート、4-メトキシフェニル ジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネー ト、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム。ト リフルオロメタンスルホネート、p-トリルジフェニル スルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、p-トリルジフェニルスルホニウム パーフルオロブタンス ルホネート、p - トリルジフェニルスルホニウム バー フルオロオクタンスルホネート、2,4,6-トリメチ ルフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタ ンスルホネート、4 - tert-ブチルフェニルジフェニル スルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-フェニルチオフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサ フルオロホスフェート、4 – フェニルチオフェニルジフ ェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、 1-(2-ナフトイルメチル)チオラニウム ヘキサフ ルオロアンチモネート、1-(2-ナフトイルメチル) チオラニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-ヒドロキシー1ーナフチルジメチルスルホニウム ヘキ サフルオロアンチモネート、4-ヒドロキシ-1-ナフ リフェニルスルホニウム塩、特開平7-28237号公 50 チルジメチルスルホニウム トリフルオロメタンスルホ

ネート、シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキ シル) スルホニウム トリフルオロメタンスルホネー ト、シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシ ル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホネート、 シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)ス ルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート、 【0027】3.3-ジメチル-2-オキソブチル チ アシクロペンタニウム トリフルオロメタンスルホナー ト、3,3-ジメチル-2-オキソブチル チアシクロ ペンタニウム パーフルオロブタンスルホナート、3. 3-ジメチル-2-オキソブチル チアシクロペンタニ ウム パーフルオロオクタンスルホナート、3,3-ジ メチルー2-オキソブチル チアシクロペンタニウム ブタンスルホナート、3.3-ジメチル-2-オキソブ チル チアシクロペンタニウム p-トルエンスルホナ ート、3,3-ジメチルー2-オキソブチル チアシク ロベンタニウム カンファースルホナート、3,3-ジ メチルー2-オキソブチル ジメチルスルホニウム パ ーフルオロブタンスルホナート、2-オキソブチルチア シクロペンタニウム パーフルオロブタンスルホナー ト、ジブチル(3,3-ジメチル-2-オキソブチル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、3, 3-ジメチル-2-オキソブチル チアシクロヘキサニ ウム バーフルオロブタンスルホナート、3,3-ジメ チル-2-オキソブチル (1,4-チオキサニウム) パーフルオロブタンスルホナート

【0028】2-メチル-4、6-ビス(トリクロロメ チル) -1, 3, 5-トリアジン、2, 4, 6-トリス (トリクロロメチル) -1, 3, 5-トリアジン、2-フェニルー4, 6ービス(トリクロロメチル)ー1, 3, 5 -トリアジン、2 - (4 -クロロフェニル) -4, 6 ービス (トリクロロメチル) -1, 3, 5-トリアジ ン、2-(4-メトキシフェニル)-4,6-ビス(ト リクロロメチル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(4 -メトキシ-1-ナフチル)-4,6-ビス(トリクロ ロメチル) -1, 3, 5-トリアジン、2-(ベンゾ [d] [1, 3] ジオキソラン-5-イル)-4,6-ビス (トリクロロメチル) -1, 3, 5-トリアジン、 2-(4-メトキシスチリル)-4,6-ビス(トリク [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001]4, 5-トリメトキシスチリル)-4, 6-ビス(トリ クロロメチル) ~1, 3, 5-トリアジン、2-(3, 4-ジメトキシスチリル)-4,6-ビス(トリクロロ メチル) -1, 3, 5-トリアジン、2-(2, 4-ジ メトキシスチリル)-4,6-ビス(トリクロロメチ ル) -1, 3, 5-トリアジン、2-(2-メトキシス チリル) -4, $6- \forall z ($ トリクロロメチル) -1, 3, ン、2-(4-ペンチルオキシスチリル)-4,6-ビ 50

ス(トリクロロメチル)-1,3,5-トリアジン、 【0029】ジフェニル ジスルホン、ジーpートリル ジスルホン、ビス (フェニルスルホニル) ジアゾメタ ン、ビス(4 – クロロフェニルスルホニル)ジアゾメタ ン、ビス(p-トリルスルホニル)ジアゾメタン、ビス (4-tert-ブチルフェニルスルホニル) ジアゾメタ ン、ビス(2,4-キシリルスルホニル)ジアゾメタ ン ビス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、 (ベンゾイル) (フェニルスルホニル) ジアゾメタン、 【0030】1ーベンゾイルー1ーフェニルメチル p - トルエンスルホネート (通称ベンゾイントシレー ト)、2-ベンゾイル-2-ヒドロキシ-2-フェニル エチル p-トルエンスルホネート (通称 α-メチロー ルベンゾイントシレート)、1,2,3-ベンゼントリ イル トリスメタンスルホネート、2,6-ジニトロベ ンジル p-トルエンスルホネート、2-ニトロベンジ

10

[0031] N -(フェニルスルホニルオキシ) スクシンイミド、N -(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) スクシンイミド、N -(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) フタルイミド、N -(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) -5- ノルボルネン-2 、3-ジカルボキシイミド、N -(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) ナフタルイミド、N -(10-カンファースルホニルオキシ) ナフタルイミド

ル p-トルエンスルホネート、4-ニトロベンジル

p-トルエンスルホネート、

【0032】また、一般に化学増幅型のボジ型レジスト組成物においては、塩基性化合物、特に塩基性含窒素有機化合物、例えばアミン類を、クェンチャーとして添加30 することにより、露光後の引き置きに伴う酸の失活による性能劣化を改良できることが知られており、本発明の組成物においても、このような塩基性化合物を配合するのが好ましい。クェンチャーに用いられる塩基性化合物の具体的な例としては、以下の各式で示されるようなものが挙げられる。

[0033]

11

【0034】式中、R¹¹、R¹²、R¹³、R¹³及びR

13は、互いに独立に、水素、水酸基で置換されてもよい
アルキル、水酸基で置換されてもよいシクロアルキル、
水酸基で置換されてもよいアリール又は水酸基で置換されてもよいアルコキシを表し、Aはアルキレン、カルボニル又はイミノを表す。ここで、R¹¹~R¹³で表されるアルキル及びアルコキシは、炭素数1~6程度であることができ、シクロアルキルは、炭素数5~10程度であることができ、そしてアリールは、炭素数6~10程度であることができる。また、Aで表されるアルキレンは、炭素数1~6程度であることができ、直鎖でも分岐していてもよい。

【0035】本発明のレジスト組成物は、その全固形分 量を基準に、樹脂を80~99.9重量%程度、そして 酸発生剤を0.1~20重量%程度の範囲で含有するの が好ましい。また、クェンチャーとして塩基性化合物を 用いる場合は、同じくレジスト組成物の全固形分量を基 準に、0.01~1重量%程度の範囲で含有するのが好 ましい。この組成物はまた、必要に応じて、増感剤、酸 増殖剤、溶解抑止剤、他の樹脂、界面活性剤、安定剤、 染料など、各種の添加物を少量含有することもできる。 【0036】本発明のレジスト組成物は通常、上記の各 成分が溶剤に溶解された状態でレジスト液とされ、シリ コンウェハーなどの基体上に塗布される。ここで用いる 溶剤は、各成分を溶解し、適当な乾燥速度を有し、溶剤 が蒸発した後に均一で平滑な塗膜を与えるものであれば よく、この分野で一般に用いられている溶剤が使用しう る。例えば、エチルセロソルブアセテート、メチルセロ ソルブアセテート及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートのようなグリコールエーテルエステル類、乳酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル及びピルビン酸エチルのようなエステル類、アセトン、メチルイソブチルケトン、2-ヘブタノン及びシクロヘキサノンのようなケトン類、アーブチロラクトンのような環状エステル類などを挙げることができる。これらの溶剤は、それぞれ単独で、又は2種以上組み合わせて用いることができる。

10 【0037】基体上に塗布され、乾燥されたレジスト膜には、パターニングのための露光処理が施され、次いで脱保護基反応を促進するための加熱処理を行った後、アルカリ現像液で現像される。とこで用いるアルカリ現像液は、この分野で用いられる各種のアルカリ性水溶液であることができるが、一般には、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドや(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムヒドロキシド(通称コリン)の水溶液が用いられることが多い。

[0038]

10 【実施例】次に実施例を挙げて、本発明をさらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例によってなんら 限定されるものではない。例中、含有量ないし使用量を 表す%及び部は、特記ないかぎり重量基準である。また 重重平均分子量は、ポリスチレンを標準品として、ゲル パーミェーションクロマトグラフィーにより求めた値で ある。

【0039】樹脂合成例:メタクリル酸2ーメチルー2ーアダマンチル、アクリル酸3ーヒドロキシー1ーアダマンチル、及びメタクリル酸3ーヒドロキシー1ーアダマンチル、及びメタクリル酸 ヘ + サヒト゚ロ-2-キキソ-3,5-メタソ-2H-シクロペンタ[b]フラン-6-イルを、5:2.5:2.5のモル比(20.0部:9.5部:9.5部)で仕込み、全モノマーに対して2重量倍のメチルイソブチルケトンを加えて、溶液とした。そこに、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを全モノマー量に対して2モル%添加し、85℃で約6時間加熱した。その後、反応液を大量のメタノールに注いで沈殿させる操作を行い、更に得られた樹脂のウェットケーキをメタノールで3回洗浄し精製した。その結果、重量平均分子量が約12,200の共重合体を得た。これを樹脂A1とする。

【0040】酸発生剤合成例1:酸発生剤B1の合成(1)四つ口フラスコにフェナシルブロマイド14.9 部とアセトン75部を仕込み、ことにテトラヒドロチオフェン 6.6部を滴下し、室温で18時間撹拌した。析出した結晶を濾取し、tert-ブチルメチルエーテルとアセトンの1対1(重量基準)混合溶媒80部で洗浄し、さらにtert-ブチルメチルエーテル50部で洗浄し、乾燥することにより、テトラヒドロ-1-(2-オキソ-2-フェニルエチル)-チオフェニウム ブロミド16.9部を得た。

50 (2)四つ口フラスコに(1)で得られたテトラヒドロ

-1-(2-オキソ-2-フェニルエチル)-チオフェニウム 4.00部とアセトニトリル160部を仕 込み、ここにトリフルオロメタンスルホン酸カリウム 2. 62部を仕込み、室温で18時間攪拌した。析出し た臭化カリウムを濾別し、濾液を濃縮した。ここに、ク ロロホルム150部を加え、室温で16時間攪拌し、不 溶物を濾別した。この濾液をさらに濃縮し、アセトン2 2部を加え、不溶物を濾別し、この濾液をさらに濃縮し た。濃縮残をアセトンと酢酸エチルの混合溶媒より再結 晶することにより、目的物3.41部を得た。この化合 10 物が次式で示されるテトラヒドロ-1-(2-オキソ-2-フェ ニルエチル) -チオフェニウム トリフルオロメタンス ルホナートであることを、 ¹H – NMR(日本電子製 "GX-270")で確認した。これをPAG1とする。 [0041]

13

[0042] 1H-NMR (ジメチルスルホキシドーd6、 内部標準物質テトラメチルシラン):δ (ppm) 2.16-2.32 (m, 4H); 3.46-3.64 (m, 4H); 5.31 (s, 2 H); 7.63 (m, 2H); 7.77 (m, 1H); 8.00 (m, 2H). 【0043】酸発生剤合成例2:酸発生剤B2の合成 四つ口フラスコにテトラヒドロ-1-(2-オキソ-2-フェニ ルエチル) -チオフェニウム ブロミド5.00部とア セトニトリル50部、水2.5部を仕込み、ことにパー フルオロブタンスルホン酸銀7.08部をアセトニトリ ル21. 3部に溶解させた溶液を滴下し、室温で4時間 30 H); 7.44 (m, 2H); 7.61 (m, 1H); 7.99 (m, 2H). 攪拌した。析出した臭化銀を濾別し、濾液を濃縮した。 濃縮残を酢酸エチルとtert-ブチルメチルエーテルの混 合溶媒より再結晶することにより、目的物6.77部を 得た。との化合物が次式で示されるテトラヒドロ-1-(2 _オキソ-2-フェニルエチル) _チオフェニウム パーフ ルオロブタンスルホナートであることを、 ¹H-NMR (日本電子製 "CX-270") で確認した。これをPAG2 とする。

[0044]

【0045】1H-NMR (クロロホルムーd1、内部標準*

*物質テトラメチルシラン):δ(ppm)

2.23-2.36 (m, 2H); 2.42-2.53 (m, 2H); 3.59-3.77 (m, 4H); 5.35 (s, 2H); 7.45 (m, 2H); 7.63 (m, 1 H); 7.99 (m, 2H).

14

【0046】酸発生剤合成例3:酸発生剤B3の合成 四つ口フラスコにテトラヒドロ-1-(2-オキソ-2-フェニ ルエチル) -チオフェニウム ブロミド3.00部とア セトニトリル120部を仕込み、ここにパーフルオロオ クタンスルホン酸カリウム5.62部を仕込み、室温で 24時間攪拌した。析出した臭化カリウムを濾別し、濾 液を濃縮した。ととに、クロロホルム50部を加え、室 温で16時間攪拌し、不溶物を濾別した。この濾液をさ らにクロロホルム200部に溶解し、このクロロホルム 溶液を水洗した。水洗後、クロロホルム層を濃縮し、te rt-ブチルメチルエーテルに滴下して、生成した結晶を 濾過、乾燥し、目的物4.66部を得た。この化合物が 次式で示されるテトラヒドロ-1-(2-オキソ-2-フェニル エチル) -チオフェニウム パーフルオロオクタンスル ホナートであることを、 ¹H-NMR (日本電子製 "CX 20 -270") で確認した。これをPAG3とする。

[0047]

$$\bigcap_{S} C_{8}F_{17}SO_{3}$$

【0048】¹H-NMR (クロロホルム-dl、内部標準 物質テトラメチルシラン):δ(ppm)

2.21-2.52 (m, 4H); 3.58-3.77 (m, 4H); 5.35 (s, 2

[0049] 実施例1~4及び比較例1~3

酸発生剤、樹脂を表1に示す組成と量で、クェンチャー として2、6-ジイソプロビルアニリンを表1に示す 量、及びPGMEA(プロピレングリコールモノメチル エーテルアセテート) 57部とGBL (γ-ブチロラク トン) 3部とともに混合し、さらに孔径0.2 μmのフッ 素樹脂製フィルターで濾過してレジスト液を調製した。 【0050】PAG4:4-メチルフェニルジフェニル スルホニウム パーフルオロメタンスルホネート

40 PAG5:4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロブタンスルホネート

PAG6:4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホネート

[0051]

【表1】

例 No.	樹脂	酸発生剤	クェンチャー
<u></u> 実施例 1	Al(10部)	PAG1 (0.3部)	0.0075部
	Al(10部)	PAG2 (0.43部)	0.0075部

		• •	13011 5 0 0 5
15			16
" 3	A1 (10部)	PAG3 (0.6部)	0.0075部
<i>"</i> 4	A1 (10部)	PAG3(0.6部)/PAG6(0.2部)	0.015部
	A1 (10部) A1 (10部)	PAG4 (0. 11部) PAG5 (0. 135部)	0.0075部
	A1 (10部)	PAG5 (0. 135部) PAG6 (0. 2部)	0.0075部

^{*} 実施例1~3、比較例1~3における酸発生剤の量は各々等モル量になるよう にした。

【0052】Brewer社製の "DUV-30J-14" を塗布し、2 10*【0053】実効感度: 0.18 μmのラインアンドス 15℃、60秒の条件でベークして厚さ1,600Åの 有機反射防止膜を形成させたシリコンウェハーに、上記 のレジスト液を乾燥後の膜厚が 0.39 μmとなるように スピンコートした。レジスト液塗布後は、ダイレクトホ ットプレート上にて100℃で60秒間プリベークし た。こうしてレジスト膜を形成したウェハーに、露光量 を段階的に変化させてラインアンドスペースパターンを 露光した。露光後は、ホットプレート上にて130℃で 60秒間ポストエキスポジャーベークを行い、さらに 2.38%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶 液で60秒間のパドル現像を行った。現像後のパターン を走査型電子顕微鏡で観察し、実効感度、プロファイル 及び解像度を以下の方法で調べた。

ペースパターンが1:1となる最少露光量で表示した。 【0054】プロファイル: 実効感度露光量での0. 18μmのラインアンドスペースパターンの断面形状。 【0055】解像度: 実効感度の露光量で分離するラ インアンドスペースパターンの最小寸法で表示した。 【0056】また、石英ガラスウェハー上に、上記のレ ジスト液を塗布して、上記と同様の条件でプリベークを 行った後の膜厚が0.39μmとなるようにレジスト膜を 形成させ、このレジスト膜の193nmにおける透過率を 20 測定した。これらの結果をまとめて表2に示した。 [0057] 【表2】

例 No.	実効感度	プロファイル	解像度 透過率
 実施例 1	50 m3/cm²		0.17μm 70 %
" 2	50 mJ/cm²	矩形	0.15μm 70 %
<i>"</i> 3	53 mJ/cm²	矩形	0.15μm 70 %
<i>"</i> 4	39 mJ/cm²	矩形	0.15μm 59%
———— 比較例 1	41 mJ/cm²	T-top	0.17μm 68 %
" 2	47 mJ/cm²	T-top	0.15μm 68 %
" 3	47 mJ/cm²	T-top	0.15μm 67 %

【0058】以上のとおり、実施例のレジストは、比較 例のレジストに比べてプロファイルのT-topが無く 矩形である。また、感度の低下も少なく、解像度も同等 である。

[0059]

【発明の効果】本発明の化学増幅型のポジ型レジスト組※

※成物は、樹脂成分と酸発生剤を含有し、ArFやKrF などのエキシマレーザーリソグラフィに適した組成物で あって、感度や解像度、基板への接着性などの各種レジ スト性能が良好であるとともに、プロファイルの形状に 40 優れるレジスト組成物である。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷ HOIL 21/027

識別記号

FI HOIL 21/30

テマコート (参考)

502R

(72)発明者 森馬 洋 大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住 友化学工業株式会社内 下ターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AA14 AB16 AC08 AD03 BE07 BE10 BG00 CB08 CB14 CB51 4J002 BG041 BG051 BK001 EV306 FD206 GP03 4J100 AL08P AR11P BA20P BC09P CA01 JA38